

Cu-HCP Cu-HCP铜材料特征

产品名称	Cu-HCP Cu-HCP铜材料特征
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	80.00/千克
规格参数	Cu-HCP铜带:Cu-HCP铜板 产地:美国/德国/日本/中国 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

Cu-HCP材料特征1.有很好的焊接性,可钎焊接性和耐氢脆性。2.它具有优良的冷热成型性,以及良好的耐腐蚀性。3.软态导电率IACS可达98%以上标准

Cu-HCP化学元素

Cu 99.95

P 0.001-0.005

CW021A C10300铜含量99.95%以上,属于低磷无氧铜。Cu-HCP

C10300可以进行热处理,焊接和钎焊,无需采取特殊预防措施以避免氢气脆性.HCP C10300与少量20-70ppm的磷合金化,少量的磷的量不会显著降低合金的导电性和导热性,但有助于在产品中获得均匀的晶粒尺寸。

DIN EN ASTM

SE-Cu572.0070 Cu-HCPCW021A C10300

物理特性

密度(比重)(g/cm³) 8.94

导电率{ IACS% (20) } 98

弹性模量(KN/mm²) 127

热传导率{W/(m*K)} 385

热膨胀系数 (10-6/ 20/ ~100/) 17.7

物理性能

状态 抗拉强度 延伸率 A50 硬度

(Rm , MPa) (%) (HV)

R220 220-260 33min 45-65

R240 240-300 8min 65-95

R290 290-360 4min 90-110

R360 360min 2min 110min

常规库存

牌号 状态 厚度 (mm) 宽度 (mm)

C10300 R220/ R240/ R290 0.2-3.0 20-620

工艺设备1.采用德国先进的无氧铜炉，确保生产出高质量无2.通过氮气低吹，木炭覆盖等工艺严格控制铜铸锭中氧含量，氧含量可以控制5个PPM以内，常规可以控制在10个PPM,3.检测仪器：使用氢氧分析仪定量检测材料中氧的含量。4.表面控制：精轧后加入隔层纸保护铜带表面通过选用的电解铜，精良的严格的工艺管控，确保生产出高质量的无氧铜。材料应用举例：1应用领域是电气工程，电源模块的底板，工艺设备制造和电缆行业。2.配电系统3.通信电缆4.电气和电子应用